2.關於聯傑國際

2.1 公司簡介

2.2 重要資訊與產品開發

2.3 核心價值與營運策略

2.4 企業韌性：打造韌性基石、迎戰未來挑戰

2.5 經營績效

2.1 公司簡介

聯傑國際(DAVICOM Semiconductor, Inc.)創立於 1996 年，是由聯華電子(股)公司之網路通訊團隊與美國網通專家所組成。

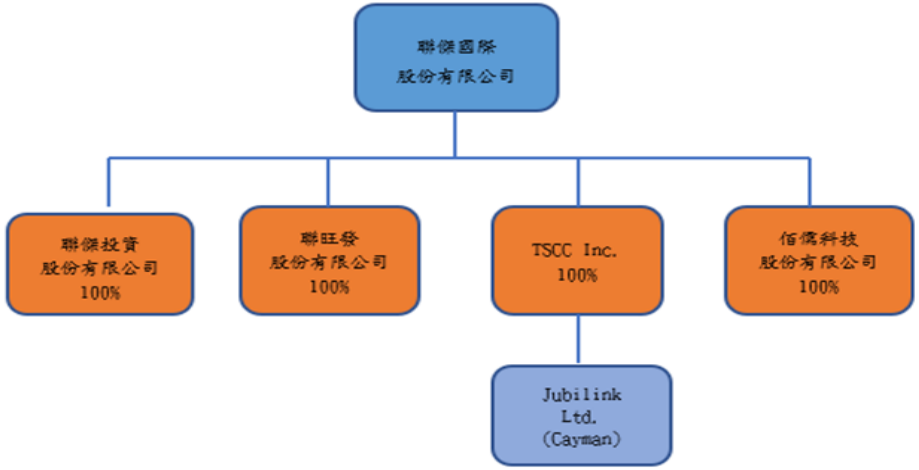
29 年來，我們在既有乙太網路(Ethernet)基礎上順應產業潮流，先後切入嵌入式系統網路晶片與軟體技術的創新與研發，在各種廣電系統上及數位電信機上盒都有極佳的績效；2013 年起我們投入智慧醫療產品的研發；2014 年我們投入 EPD (ESL)創新應用的開發；2018 年起我們更聚焦於人工智慧(AI)與固有核心技術(Ethernet)的整合與創新產品的開發，2020 年跨足 UHF RFID。我們提供最具競爭力的晶片與解決方案，協助客戶掌握智慧物聯網(AIoT)發展的最新趨勢，以縮短產品開發期程，掌握市場先機。

「網網相連、聯無止境」是聯傑國際的永續願景，「開發並推廣對環境友善的科技」是我們的使命，「前瞻、穩健」是我們的基因，「客戶滿意、合理利潤」是我們的堅持。我們本著「行穩致遠」的信念，朝企業永續之目標前進。全員上下一心，持續的創造「社會和諧、經濟永續、環境永續」三者平衡之永續價值。

組織概況

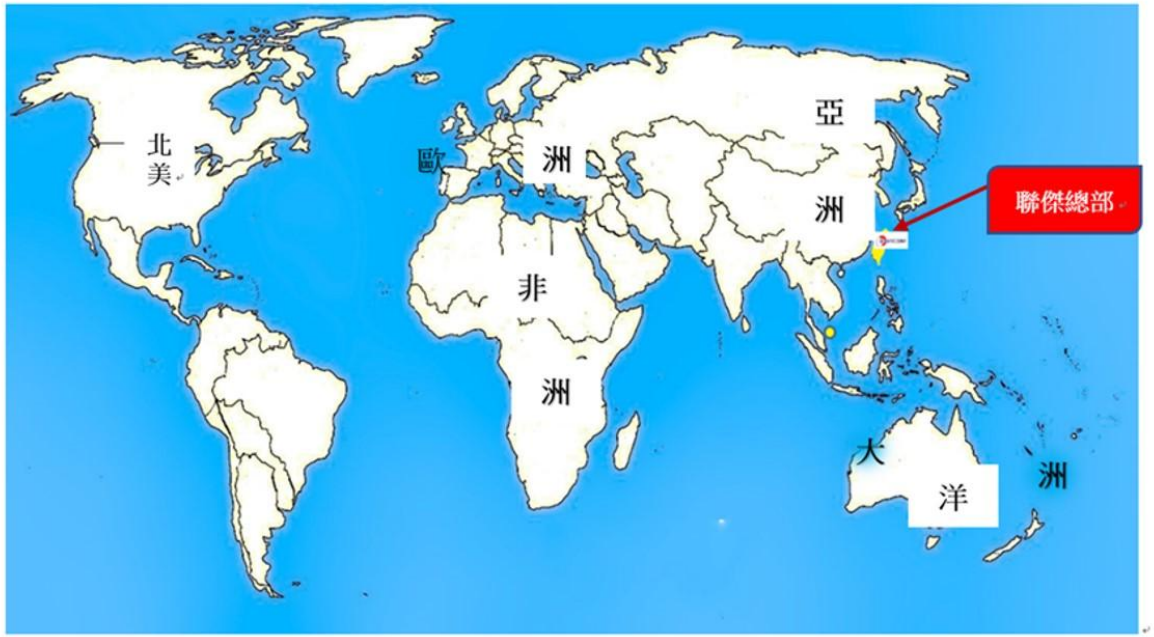
組織名稱	聯傑國際股份有限公司
資 本 額	新台幣 8.31 億
員工人數	70
成立日期	1996 年 8 月 16 日
股票上市	2007 年 8 月 6 日於台灣證券交易所掛牌上市(股票代號：3094)
董 事 長	郝 挺
總 經 理	林有亮
營運總部	新竹市科學園區力行六路 6 號
營運地區	台灣、中國、歐洲、美國

聯傑國際關係企業架構



企業名稱	設立/投資時間	地址	實收資本額	主要營業項目
聯傑投資股份有限公司	95年4月	新竹市新莊街53巷1號2樓	新台幣212,000仟元	一般投資業
聯旺發股份有限公司	99年7月	新竹市新莊街53巷1號2樓	新台幣1,000仟元	IC設計製造業
佰儒科技股份有限公司	105年4月	新竹市東區軍功里建新路60之3號十五樓之3	新台幣80,000仟元	無線通信機械器材製造業
TSCC Inc.	91年1月	TrustNet Chambers, Poteau P.O. Box 1225, Apia, Samoa.	美金4,400仟元	一般投資業
Jubilink Ltd.	91年1月	P.O. Box 219, Grand Cayman	美金2,500仟元	一般投資業

全球代理商據點(詳細資訊請參見聯傑官網首頁>聯絡我們)



歐洲地區

法國
荷蘭 / 比利時 / 義大利 / 西班牙
以色列 / 烏克蘭
德國 / 瑞士 / 奧地利
挪威
芬蘭
波蘭
丹麥
瑞典
英國 / 愛爾蘭 / 土耳其

亞洲區代理商

日本
韓國
印度
東南亞
中國

非洲代理商

南　非

大洋洲代理商

紐西蘭/澳洲地區

2.2 重要資訊與產品開發

年度	重要資訊與產品開發
1996	公司正式成立於新竹科學園區，創業時實收資本額為新台幣 1.3 億
1997	1. 現金增資新台幣 0.6 億元，增資後實收資本額 1.9 億元 2. 推出二合一網路卡晶片 DM9101F 3. 現金增資新台幣 0.5 億元，增資後實收資本額 2.4 億元 4. 通過 ISO9001 認證
1998	推出三合一網路卡晶片 DM9102F
1999	1. 現金增資 1.6 億元，增資後實收資本額 4 億元 2. 推出 56K 數據機晶片 DM560P 3. 推出家用網路實體層/收發晶片 DM9801 4. 證期會核准公開發行
2000	1. 辦理盈餘及員工紅利轉增資新台幣 1.095 億元，增資後實收資本額新台幣 5.095 億元 2. 推出三合一網路晶片 DM9102A
2001	1. 辦理盈餘及員工紅利轉增資新台幣 0.2188 億元，增資後實收資本額 5.3138 億元 2. 推出三合一 NON PCI 網路晶片 DM9000
2002	1. 推出光纖轉換器晶片 DM9331A 2. 通過興櫃掛牌

年度	重要資訊與產品開發
2003	1. 推出世界最小的紅外線數據機 IrDA MODEM Module 2. 開發完成 802.11b WLAN MAC 控制晶片 3. 開發完成 10/100M 0.25μm PHY 晶片 4. 推出 DM9700，1.8/3.3V 0.18μm 10/1000/1000M Base - TX 超高速乙太網路(Gigabit) MAC 控制器晶片 5. 推出 DM9102C，2.5 / 3.3V 0.25μm 10 / 100M Base - TX Integrated PCI 匯流排嵌入式系統單晶片 6. 通過 ISO9001：2000 年版認證 7. 推出 DM562AP，2.5 / 3.3V 0.25μm 33.6k 多功能傳真數據機雙晶片組，SRAM 內建
2004	1. 公司搬遷至新建大樓 2. 現金增資新台幣 1.0862 億元，增資後實收資本額 6.4 億元 3. 取得工業局科技類上市推薦書 4. 推出 DM3003 十一合一 USB2.0 Card Reader 5. 開發完成 DM8603 Gigabit Switch
2005	1. 提供符合 RoHS 環保產品 2. 推出 DM6588A-E5 2.5 / 3.3V 0.25μm 具來電顯示雙向單工多功能傳真數據機晶片 3. 推出高速乙太網路嵌入式晶片組加強版 DM9000A-E7
2006	1. 推出網路處理器整合晶片 DM9218 及 IP-CAM 整體方案 2. 產品符合 SONY SS-00259 認證 3. 推出嵌入式交換器控制晶片 DM9013 4. 提供符合工業規格的產品 5. 推出 DM6588A-E6 2.5 / 3.3V 0.25μm 同步數據及 33.6K 多功能傳真數據機晶片

年度	重要資訊與產品開發
2007	1. 推出 0.18μm 嵌入式處理器介面高速乙太網路晶片組 DM9000B 2. 推出 0.18μm 高速乙太網路實體層收發器及加強版 DM9161B 3. 取得經濟部工業局科技類上市推薦書 4. 盈餘配股及員工紅利轉增資 0.10542 億，增資後實收資本額新台幣 7.007 億元 5. 嵌入式多埠交換晶片(DM9003/DM9103)量產導入市場 6. 現金增資 0.9343 億，增資後實收資本額新台幣 7.94131 億元 7. 8 月 6 日於台灣證券交易所正式掛牌上市(電子類股代號 3094) 8. 推出嵌入式系統專用 PCI 介面 0.18um 高速乙太網路單晶片 DM9102H
2008	1. 推出 IP2001 MPEG4 IP Camera 解決方案 2. 推出嵌入式網路流量交換器控制晶片 DM9016
2009	1. 推出嵌入式系統專用 USB2.0 介面高速乙太網路單晶片 DM9620 2. 推出低腳數高速乙太網路光纖介質轉換單晶片 DM9302 3. 通過 ISO9001 : 2008 改版及換證稽核 4. 推出 USB2.0 Dongle 專用高速乙太網路單晶片 DM9621
2010	1. 開發 802.3az 節能技術 2. 推出低功率改良版高速乙太網路實體層晶片 DM9161C 3. DM9620 & DM9621 獲得 USB IF 認證 (ITD40001021) 4. 推出六埠網路交換器 DM8606C 5. 推出三埠網路交換器 DM8603/DM8203 6. 聯傑國際榮獲 2010 年渣打中小企業金質獎 7. DM9620 & DM9621 獲得微軟驅動程式認證 8. 開發 IEEE1588 精確時間同步協定技術

年度	重要資訊與產品開發
2011	1. 開發 DM8806 工業用等級交換器 2. 開發 DM8603A 容錯型光纖交換器 3. 開發 DM9633 USB3.0 超高速乙太網路晶片 4. 推出 DM9162 實體層 0.162um 全新製程晶片
2012	1. 推出 DM9620A / DM9621A 新型即插即用 USB 介面高速乙太網路晶片 2. 推出 DM8806 / DM8806I 支援同步協定工業用等級交換器晶片 3. 推出聽覺輔助軟體 HearingAmp 於 iTunes Store 上架 4. 推出醫電遠距照護回傳系統硬體、韌體與伺服器平台
2013	1. 推出新 IC 產品線 Video Decoder 視頻影像解碼器 1-Channel：DM5900 / DM5960 / DM5150 / DM5160 2. 推出聽覺輔助器軟體 HearingAmp V1.2 於 iTunes Store 上架 3. 推出新 IC 產品線 Video Decoder 視頻影像解碼器 4-Channel：DM5865 / DM5866 / DM5885 / DM5886 4. 推出聽覺輔助器軟體 HearingAmp V1.3 於 iTunes Store 上架 5. 推出無線醫電遠距照護回傳系統 Apps
2014	1. 推出 DM9051 物聯網 SPI Mac Controller 2. 併購天晶科技 EPD Driver 和 SoC IC 產品線 3. 推出 DM9051 工業用等級 SPI 介面高速乙太網路晶片 4. 推出 DM9163 智慧電網採集器與集中器 5. 推出 DM9162A 24-pin 10/100M PHY 6. 推出 DM120C16EP、DM130036GP 電子紙驅動 IC (SOC & Driver) 7. 推出聽覺輔助器軟體 HearingAmp V1.4 於 iTunes Store 上架 8. 推出聽覺輔助器軟體 HearingAmp V1.5 於 iTunes Store 上架 9. 推出 DM171F08D、DM118P08D 醫療及消費性電子產品微控制器

年度	重要資訊與產品開發
2015	1. 推出 DM5900N 視訊解碼(QFN 包裝) 2. 開發嵌入式行動助聽系統 HearingPod V1.0 3. 開發省電型電壓模式傳送電路的高速乙太網路傳收晶片
2016	1. 推出聽覺輔助器軟體 HearingAmp V1.6 於 iTunes Store 上架 2. 開發完成可俱彈性運算的數位型式來實現可精準控制類比電路之架構適於醫療級產品及應用 3. 完成前瞻聽力協助平台 HearingPod V1.1 智慧型裝置 4. 推出聽覺輔助器軟體 HearingAmp V1.7 於 iTunes Store 上架
2017	1. 完成前瞻聽力協助平台 HearingPod V1.3 智慧型裝置 2. 開發 ESL 巨量節點溝通之貨架標應用系統 3. 完成 in-audio IoT 聽力協助平台 HearingPod V1.3 支援雲端遠距設定之智慧型輔聽系統 4. 開發依環境溫度自動截取最適合的顯示波形時間模式暨 RF 電源驅動電子紙驅動晶片(EPD)
2018	1. 本公司與韓系 SoC 品牌大廠以 DM5886 合作開發車載環視系統方案 2. 本公司榮獲「第四屆公司治理評鑑」上市上櫃公司前 5%「最佳績優生」獎項榮譽
2019	1. 推出 DM8111XP 人工智能晶片, 跨足 AIoT 領域 2. 推出 DM9119INP Ethernet Gigabit (10/100/1000) 網路實體層傳輸晶片產品 3. 推出 DM130126 電子紙 3 色顯示 126 段段碼式驅動晶片產品，適合於電池驅動之低功耗應用
2020	1. 開發 RFID 資料軌跡演算法 2. 開發影像 AIoT 與 RFID 異質資料融合技術

年度	重要資訊與產品開發
2021	1. 開發邊緣運算人工智慧(Edge AI)晶片之演算法及權重模型系統應用 2. 開發無線射頻識別系統暨人工智慧運算之精準定位人/物系統 3. 開發 Ethernet 即時網路應用協定與演算法
2022	1. 推出 DM9625I USB-to-UART 產品 2. 新開發 36 段電子紙顯示驅動(EPD)IC
2023	1. 開發單對線乙太網路聯盟制定的串列式周邊介面 IP 和 IC 2. 開發無線射頻識別系統結合人工智慧運算-網路式智慧工廠生產履歷系統
2024	1. 開發高精準度時間同步網路控制器晶片 2. 開發邊緣運算的機器學習模型優化與生產履歷追溯系統
2025	1. 開發時限內建硬體時間戳記機制符合 IEEE 1588v2 PTP 標準的乙太網路收發器晶片 2. 研發出符合 IEEE802.3cg 標準的 10Base-T1S 晶片

註：聯傑國際財務資訊公開於公司網站，敬請參閱聯傑國際股份有限公司官網：投資人關係財務資訊 & 公司年報

網址：https://www.davicom.com.tw/investor-annualreport.php?lang_id=tw



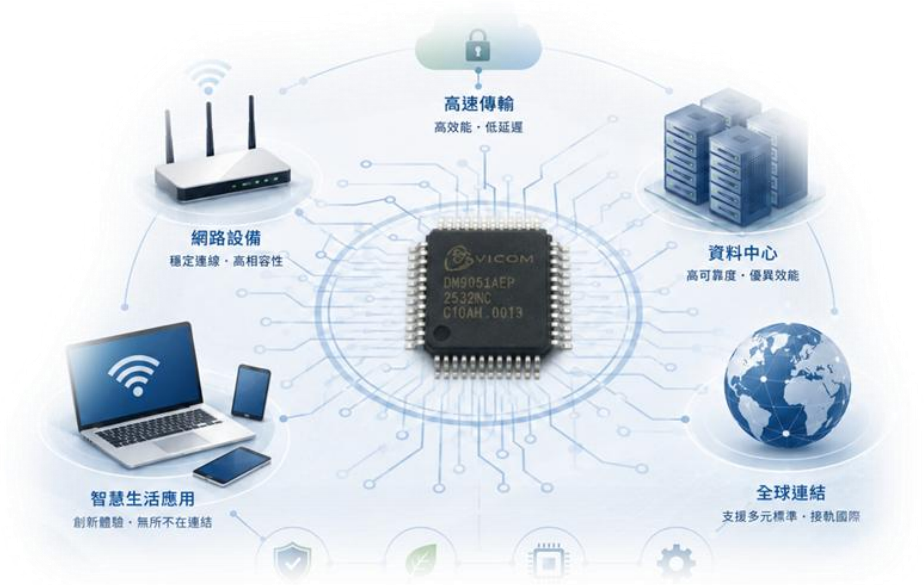
2.3 核心價值與營運策略

聯傑國際(DAVICOM)成立 29 年，「以人為本、堅持誠信、穩健經營」是公司的核心價值。進而發展出「Diligence、Agility、Value、Integrity、Cooperation、Opportunity、Modesty」的企業文化。聯傑國際始終專注於 IC 設計本業，網路通訊晶片在全球綠色供應鏈上不斷地創造價值，並與員工、股東、客戶、供應商等利害關係人建立良好互動，同時關心教育、文化、藝術之發展，善盡企業公民責任，追求永續發展。



Ethernet MAC & PHY 乙太網路控制器及收發器	Mixed Signal 數位類比混和訊號處理	RFID Omni-Solution 無線射頻辨識 全方位系統方案
Networking Protocol Stacks 有線及無線網路通訊協定	AIoT & Algorithms 人工智慧物聯網及演算法	Video Decoder 視訊解碼器
USB 及 Interfaces USB 及相關資料傳輸介面	Audio Signal Processing 音頻訊號處理	DSP & Algorithms 數位訊號處理及 相關演算法

▲核心技術



2.4 企業韌性：打造韌性基石，迎戰未來挑戰

聯傑國際將「企業韌性」列為 ESG 次要重大主題之一，展現公司重視風險治理與永續經營。根據利害關係人調查及衝擊評估結果，企業韌性於正向效益及負向風險均具有高度重要性，反映其對營運穩定、利害關係人權益及企業永續發展具關鍵影響。聯傑國際將持續強化風險管理與應變能力，提升營運韌性，因應外部環境變化與市場挑戰。

項目	內容
以創新研發：打造競爭護城河	聯傑國際持續投入研發，2025 年投入研發經費 67,356 仟元，占營業比重 36%，推出 DM9051 系列低功耗產品，功耗降低 62.5%，提升產品能源使用率。主力產品包括乙太網路通訊 IC、電子紙驅動器（EPD）、視頻解碼器（VD）與 AI 處理器（AI SoC）。節能與智慧應用成為研發核心，推出以 UHF RFID 為核心的智慧物流系統，展現技術與市場雙軌布局的韌性實力。
與價值鏈合作，強化供應鏈的協同應變力	面對全球供應鏈斷鏈風險，聯傑國際積極與上游晶圓廠（如聯電）、封裝測試廠（如矽品）及代理通路建立穩定合作夥伴關係。以綠色供應鏈與 ESG 準則為準繩，提升整體價值鏈的抗風險能力與永續韌性。
營造幸福職場，以人為本，厚植企業韌性	韌性企業的根基來自員工。聯傑國際致力營造多元、健康、安全的工作環境。員工意見信箱與勞資會議制度，讓公司隨時掌握組織脈動與內部風險，有效強化內部韌性。
注重風險治理，前瞻風險分類與管理	聯傑國際導入全面風險控管制度，將風險區分為營運風險、資安風險、地緣政治風險、氣候風險等多類型，並成立永續發展委員會進行監督與動態調整。實務上，如因應 COVID-19 即快速調整庫存策略與供應商協議、調整行銷策略迴避地緣政治的不利因素，展現卓越的應變效率。

2.5 經營績效

2025 年，全球經濟仍受俄烏戰爭、中東地緣政治衝突及美國貿易關稅政策等因素影響，供應鏈運作及市場需求面臨高度不確定性，對公司產品銷售帶來挑戰。然而，隨著生成式 AI 快速發展，結合邊緣運算（Edge AI）與雲端運算的混合式 AI 應用日益普及，帶動各產業積極投入智慧化產品的研發與應用，為半導體產業創造新的成長契機。

面對地緣政治風險、全球供應鏈重組及市場環境變化，聯傑國際持續秉持穩健經營與創新發展理念，積極拓展新市場、深化核心技術研發，並持續佈局高成長應用領域。2025 年，公司成功導入電子驗證健康指環等新興應用產品，並完成單對乙太網路（Single Pair Ethernet, SPE）晶片開發，持續提升產品競爭力，為未來營運成長與永續發展奠定基礎。聯傑的企業文化帶領員工們埋頭打拼，創造了連續 76 季每季均獲利的佳績。

經營績效評估

聯傑國際受到受全球地緣政治風險、貿易政策變動及供應鏈重組影響，2025 年仍配發現金股利 0.25 元，自 2016 年起每年均配發股利。聯傑國際 2025 年資產負債表、損益表、現金流量表等財務資訊，請參閱聯傑國際官網：
https://www.davicom.com.tw/investor-finance01.php?lang_id=tw

或台灣證券交易所公開資訊觀測站：(聯傑國際股票代號：3094)
https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/index